

Таблица 1

Условное		Материал слоя						
обозначение слоя	Наименование слоя	Марка	гост, ост, ту	Электрическая характеристика	Метод нанесения			
7////	Проводники и контактные площадки	Нихром X20H80	ГОСТ 10994—74	0.04 OM	Фотолитографический			
		Золото Зл9999	ГОСТ 6835—72	0.04 OM	Фотолитографический			
	Резистивный слой	Сплав PC—3001	ETO.021019 TY	10 кОм	Фотолитографический			
	Защитный слой	Фоторезист негативн. ФН—11	TY-14-631-7B					

инв.

- 1. Размеры для справок (мм). 2. Элементы в слоях выполнять по координатам, приведенным в таблицах на соответствующих листах
- 3. Характеристики отдельных слоев приведены в табл. 1. 4. Номера контактных площадок и обозначение элементов показаны условно и соответствуют схеме электрической принципиальной АБ. XXXXXX 001 ЭЗ.

4			<i>a</i> coc	лпоетстоук	OIII CAGM	9710	ктрической принципиальной АБ.ХХ	VVV. (<i>501</i> s	<i>)</i>		
gama					АБ. ХХХХХХ. С	АБ. XXXXXX. 002 CБ						
n.u								Лит. Мо		Мас	cca	Масштаб
Поап.)	Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Резистивная микросборка					
		Разраб.		Жеребин В.Р.			т езистионая макросоорка Сборочный чертеж			10		10:1
Инв. подл.		Пров	в.				coope made repimen					
	5	Т. контр.					Лист 2			Листов 5		
										Ш	1V M21	,
		Н. контр. Утв.									1Y MЭV 151	
										٠,	, 0 ,	